

tesa[®] HAF 8416

产品信息



半透明 Z 轴导电型热敏胶带

产品描述

德莎[®] 热敏胶带 8416 (tesa HAF[®] 8416) 是一款填充导电粒子的半透明热反应性胶粘薄膜。

特点

- 一步完成芯片模块粘接与电路导通
- 适配所有主流芯片植入生产线，加工性能优越
- 适用于 PVC、ABS、PC 材质卡基（双界面卡 DI 与非接触式卡）
- 适用于银浆油墨基材与线圈天线
- 平均粒径：40 μm

应用

德莎[®] 热敏胶带 8416 (tesa HAF[®] 8416) 专为需同时实现可靠电导通与高强度粘接的应用场景设计。核心应用为双界面（DI）卡的芯片模块植入以及射频识别（RFID）标签制作。

技术参数（平均值）

这里的数据仅应被视为参考值和典型值，不应被视为技术规范。

产品结构

- | | | | |
|---------|------|---------|-------|
| • 基材 | 无 | • 离型纸类型 | 玻璃纤维纸 |
| • 胶粘剂类型 | 共聚酰胺 | • 颜色 | 半透明 |

附加信息

加工说明:

请注意最优工艺参数高度取决于设备型号、卡基材质、天线材料、芯片模块类型以及客户的个性化需求。粘接时长由所用基材的热传导性能决定。此外，我们建议粘接工序完成后立即进行冷却处理。冷却过程中需持续施压，直至胶带温度降至软化温度以下（约 110°C）。

以下参数为设备初始调试的推荐参考值。

1. 预层压:

预层压工序将胶粘带贴合至模块载带上。对于德莎[®] 热敏胶带 8416 而言，精准的预层压是保障成品内部粘接强度与导电性能的核心前提。

设备参数设置:

- 温度：130 - 150 °C
- 压力：3 - 4 bar

如需查询有关产品的最新信息，请访问 <http://l.tesa.com/?ip=8416>

tesa[®] HAF 8416

产品信息

附加信息

- 线速: 2.5 m/min.

2. 导电粘接:

芯片植入工序中, 将完成预层压的模块从载带上模切取下, 定位至卡基凹槽内, 通过加热加压实现与卡体的永久固定。根据植入生产线的类型, 可采用单步或多步工艺。目前主流植入设备均采用多段热压工艺。

单步工艺 — 设备参数设置:

- 温度¹: 160 – 220 °C
- 压力: 65 - 130 N/module
- 时长: 1.5 s

多步工艺 (2 段及以上热压头) — 设备参数设置:

- 温度¹: 180 – 220 °C
- 压力: 65 - 130N/module
- 时长: 2 x 0,7 s. / 3 x 0.5 s.

¹推荐温度为热压头内部实测温度。不同卡基材质对应推荐温度如下: :

- PVC 180 – 190 °C
- ABS 180 – 190 °C
- PET 190 – 200 °C
- PC 200 – 220 °C

为达到最优粘接强度, 待粘接表面需保持清洁干燥。储存条件请遵循德莎热敏胶带[®] 系列产品存储寿命规范。

免责声明

德莎产品定期经受严格的检验, 在各种苛刻的条件下不断证明着自己卓然的优秀品质。我们在此提供的技术信息均来自我们基于实践经验获取的全部知识。这些技术参数应被看作平均值, 而不可用于规范目的。因此, 德莎不能做出任何明确或者隐含的担保——包含但不仅限于任何隐含的商品保证或适用于某特定目标的保证。因此, 对于德莎产品是否适于某特定用途及适用于使用者的应用方法, 使用者需要为自己的决定负责。如果您有任何疑问, 我们专业的技术支持人员将非常乐意为您提供专业的咨询。



如需查询有关产品的最新信息, 请访问 <http://l.tesa.com/?ip=8416>